

• 設備規格 Specification 仕様

可量測板厚 Board thickness	板厚測定範圍	0.125 ~ 4.5mm
可量測板面大小 Board Size	板寸法測定範圍	Max.: 25.5"×25.5" / Min.: 12"× 10"
產速 Capacity	測定能力	8 pcs/min.

• 設備特點 Features 特長

1. 非接觸、行進間量測，不刮傷板面，不影響產能。

Contact-free, non-stop measuring.

走行中に測定できる。しかも非接触的に測定するため、表面に傷をつけることはない。

2. 人工設定量測位置，可任選量測 1~12 點。

Setup the measuring position by PC Key-in, 1 to 12 points selectable.

1 点測定から最大 12 点測定までのバリエーションをお客様に選択していただけます。

3. 雷射量測頻率 Measure frequency: 2500 次/秒 (times/sec)

レーザー測定頻度: 2500 回/秒

4. 動態量測精度 Dynamic measure accuracy: $\pm 6\sim 8\mu\text{m}$

(精度會受環境因素而影響 The ambient condition depends.)

行進間測定精度: $\pm 6\sim 8\mu\text{m}$ (環境条件による精度を変化させることがある)

• 用途 Purpose 用途

成品板或多層板壓合厚度之量測

Thickness measuring for multi-layers, finish board.

プリント基板ならびに多層プリント基板の板厚測定用。

JH-510 雷射測厚機

JH-510 Laser Thickness Tester

JH-510 レーザー板厚測定機



捷惠自動機械有限公司
JHY HUEY AUTO MACHINE CO., LTD